

Lagenaufbau

Ebe	ene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Тур
		-A /	Cu+galv.Cu		18+25	
1			Prepreg	0.068		1080
			Prepreg	0.068		1080
2			Cu Tr-Lam	0.25	35	
3			Cu Prepreg	0.068	35	1080
			Prepreg	0.068		1080
4			Cu Tr-Lam Cu	0.25	35 35	
5			Prepreg	0.068		1080
		1/2	Prepreg	0.068		1080
6			Cu Tr-Lam	0.25	35	
7			Cu		35	
			Prepreg	0.068		1080
			Prepreg	0.068		1080
8			Cu+galv.Cu		18+25	

Presslingsdicke *	1,50 +/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske *	1,61 +/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe





Designrules zum Lagenaufbau

Designifics Zum Et	agonaanaa	
Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm
(vide)	Viapad-Ø	≥ 500 µm
Leiterbild Außenlagen		
	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm ≥ 100 µm
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥100 µm ≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm ≥ 175 µm
	Leiterbreite bei 70 μm Grundkupfer Leiterabstand bei 70 μm Grundkupfer	≥ 190 µm ≥ 240 µm
Leiterbild Innenlagen		
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm ≥ 80 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 μm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 μm Grundkupfer	≥85 µm ≥ 100 µm